# アームロボット用非接触給電のための 直列共振回路における多層円板コンデンサの提案

Multilayer disc capacitor in series resonant circuit for wireless power transmission on an arm robot

# 福森 康洋, 植村 涉, 粟井 郁雄

Yasuhiro FUKUMORI, Wataru UEMURA and Ikuo AWAI 龍谷大学,株式会社リューテック

#### Ryukoku University, Ryu-tech

fukumori@vega.elec.ryukoku.ac.jp, wataru@rins.ryukoku.ac.jp, awai@ryutech.com

#### Abstract

アームロボットの電力線が疲労切断の危険性及 びケーブルによってアームの動きが阻害,制限 される問題に対して,共振回路による非接触給 電法を用いる研究が成されている.アームロボッ トには上腕部分に近づくにつれて,小型化して いくタイプがある.この場合,アームの上腕部分 の関節へ近づくほど受電装置のスペースも小さ くなる.その状況下でも全体の共振周波数を保 つには共振回路の素子である円板コンデンサの 直径を小さくしても容量が変化しない方法,あ るいはコイル側のインダクタンスを増加する方 法が必要となる.

本論文は関節部に取り付けるコンデンサ及びコ イルを小型化する手法について検討する.また 実際にそれらを用いた共振回路を作製し,その 伝送効率やアーム部分の多段化に適した回路構 造についても検討していく.

## 1 はじめに

近年,アームロボットの高速性が向上し,それに伴い,アームロボットの関節は幾度も屈曲する.その影響により,アームロボットに取り付けている電力線に負荷がかかり,疲労断線することが危惧されている.また,アームロボットに幾本も取り付けている電力線はロボットの屈曲,回転を阻害する危険性がある.それらの問題の解決策として, 非接触給電が求められている.

従来の方法では共振回路をアームロボットに組み込み, その共振回路に必要な静電容量成分であるコンデンサと して回転円板コンデンサを取り付ける.それにより,円 板コンデンサが関節部分を担う方法が提案されている[1]. しかし,アームロボットには上腕に行くほどアームが細



Figure 1: 従来のアームロボット用共振回路

く,小型化するタイプも存在する.そのアームロボットに 実装する場合,共振回路の要素であるコンデンサ,コイ ルを小型化する必要がある.その場合静電容量はコンデ ンサの面積に依存するので,容量が減少する.それに伴 い,共振周波数が変化する.この時,全体の共振周波数を 一定に保つ方法が必要になる.

また,従来法の回路は Figure 1 のように,不安定な対 地容量を防ぐためにコンデンサを縦続に接続する[2].そ の際,コンデンサはインバータを形成しインピーダンスが 反転する.そのため,コイルのインバータでインピーダン スをさらに反転し,元に戻す必要があり,回路構造が複雑 になる.さらに,Figure 1 の回路は並列共振回路を構成 し,Figure 2 のように共振周波数帯近傍でのインピーダ ンス虚部が大きく変動する.インピーダンス虚部が0か ら遠ざかるほど伝送効率は低下していく.また,アームロ ボットは,複数の関節で構成しているのでその関節ごとに 共振回路が必要になる.したがって,共振周波数を全て一 致する際には,Figure 1 のような回路を用いた多段化は, 多少の誤差が大きな伝送効率の低下へ直結する.

## 2 共振回路

#### 2.1 コイル

コイルの小型化の際にはインダクタンスとQ値も考慮しなければならない.Q値とは,コイルの良さを表す指標



Figure 2: 並列共振時のインピーダンス虚部の変化

であり,式1で求めることができる[3].

$$Q = \frac{\omega L}{R} \tag{1}$$

コイルには巻き方によりいくつかの種類が存在する.例 えば,2次元平面上で銅線を渦上に巻いたコイルをスパイ ラルコイルと呼ぶ.このコイルの場合,高いQ値が得ら れるが,インダクタンスが小さくなる.インダクタンスは 銅線の巻数を増加することで増えるが,その代わりにQ 値が下がる.また,巻数を増加することで広いスペース が必要となる.したがって,スパイラルコイルは本研究の 意向に沿わない.本研究ではこのトレードオフを考慮し, スパイラルコイルに比べ,Q値が下がる代わりに小型で 大きなインダクタンスを得ることのできるフェライトコ アを用いたソレノイドコイルを共振回路のコイルとする. ソレノイドコイルは銅線を螺旋状に巻いたコイルのこと である.

#### 2.2 コンデンサ

コンデンサの容量 C は物質の比誘電率を $\varepsilon_r$ , 空気の誘電 率を $\varepsilon_0$ , コンデンサの面積をS, 極板同士の距離をd と した時の式 2 から求められる.

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} \tag{2}$$

式2より,コンデンサの容量は,面積の大きさに依存する とともに,コンデンサ同士の距離にも依存することがわ かる.また,コンデンサ同士の合成容量は並列に接続す ることでその数に比例して増加する.そこで,我々は銅貼 り基板を Figure 3 のように多層に重ね合わせ互い違いに 銅線を接続し,導通することで並列に接続させる.これ により,容量を増加させることが可能である.また,式2 よりコンデンサ同士の距離が近づくほど容量は増加する. Figure 3 において,距離 d とは銅貼り基板の誘電体の厚 さとなる.したがって基板が薄ければ薄くなるほど容量 は増加し,かつ複数枚利用に必要なスペースを縮小する ことができる.それに伴い,コンデンサの面積 S の大き さを最小限に抑え,小型化することが可能になる.また, コンデンサは極板 2 枚一対で動作するので,n 枚の円板 がある場合,できるコンデンサはn/2 個となる.しかし,



Figure 3: 誘電体多層円板コンデンサ



Figure 4: 直列共振回路

Figure 3 の場合,中で挟まれている円板同士もコンデン サとしての働きをするのでコンデンサはn-1個として動 作する.

#### 2.3 直列共振回路

前節で述べた通り,従来法の回路では回路の多段化への対応が困難となる.したがって,本研究では対地容量を無視できるものとして Figure 4 のような直列共振回路を作製した.直列共振回路にすることで,インバータが不要となり,かつ Figure 2 と比較すると Figure 5 のように共振周波数帯近傍でのインピーダンス虚部の変動が緩やかである.これにより,回路の多段化の際に,共振周波数を一致するのが容易となる.



Figure 5: 直列共振時のインピーダンス虚部の変化





Figure 6: コイルのインダクタンスと Q 値 ( $\phi$ 0.4)



Figure 7: コイルのインダクタンスとQ値( $\phi 0.6$ )

### 3 検証実験

3.1 ソレノイドコイル

本研究では共振周波数を 1MHz とする.本節では,用いるフェライトコアの最も高いQ値を得る事ができる周波数帯を調べ,ソレノイドコイルとして用いる際に 1MHz 帯での使用に適しているかを検証する.直径 6.15mmのトミタ電機製 Ni-Zn フェライトコア 5B3 に対し,銅線 0.4mm,0.6mm( $\phi$ 0.4, $\phi$ 0.6)を1重の均等巻きにし,Vector Network Analyzer (VNA)を用いて巻数をパラメータとした周波数に対するインダクタンス,Q値を測定した.結果はそれぞれ Figure 6, Figure 7 となった.結果より, $\phi$ 0.4, $\phi$ 0.6 ともに,Q値が最も高くなる周波数帯域は5~6MHz 近傍となった.しかし,巻数が増加し,インダクタンスが増加していくと,5MHz 近傍でコイルが自己共振をし始めている.これより,1重巻きで大きいインダクタンスが必要な場合,最もQ値が高くなる5MHz帯よりも1~3MHz帯での使用が適している.

## 3.2 誘電体多層円板コンデンサ

本節では前節で述べた誘電体多層円板コンデンサの効果 を検証する.銅貼り基板の FR-4(d = 1.5mm),レジン 基板 (d = 0.3mm)をそれぞれ用いて円板を作製し,6枚 を重ね合わせ,Figure 3を作製する.それぞれの容量と Equivalent Series Resistance (等価直列抵抗,ESR)を測 定する.Figure 8より,FR-4に比べ,レジン基板は厚さ が薄いため,円板同士の距離dが小さくなり,容量が 3.5



Figure 8: コンデンサの容量と等価直列抵抗



Figure 9:2 段直列共振回路

倍大きくなった.また,理想的なコンデンサは静電容量が 大きいほどインピーダンスが低く,かつ周波数が高くなる ほどインピーダンスが低くなるのに対して,実際のコン デンサには抵抗成分やインダクタンス成分が含まれてお り,この抵抗成分が等価直列抵抗である.インダクタンス 成分があると周波数が高くなると静電容量とは対称的に インピーダンスが高くなる.また,コンデンサの容量と インダクタンス成分の共振周波数帯では等価直列抵抗の 値がインピーダンスになる.等価直列抵抗が高くなると, 発熱や,電圧低下などの問題が発生するので極力抑える ことが好ましい.Figure 8 より,レジン基板は,FR-4 に 比べ等価直列抵抗も約 45 倍小さくなった.

#### 3.3 直列共振回路のインピーダンス虚部と電力

本研究では直列共振回路を Figure 9 のように作製し,電 源側から近い負荷抵抗を順に 0次,1次,2次側負荷抵抗 とし,それぞれ $R_0$ , $R_1$ , $R_2$ とした.これらの負荷抵抗 をアームロボットのサーボモータと想定する.サーボモー タは動作開始時には大電力を必要とするが,動作安定後要 求する電力は減少する.さらに,印加する電圧は一定であ ることからサーボモータの抵抗値は動作の状態で変動す る.この動作を想定し,それぞれの負荷を独立に変動し, その際の電源から見たインピーダンス Z を VNA で測定 する.他の抵抗は 100 $\Omega$ , 390 $\Omega$  で固定する. Figure 9 ~ 12 の結果から 0 次から 2 次のどの負荷が変化しても,電 源から見たインピーダンスの虚部は 0 $\Omega$  近傍で維持するこ とができ,多段化した際に共振周波数の調整が容易にで きることがわかる.また,対地容量の影響も無視できる程 度のものだと確認できた.



Figure 10: 0 次負荷を変化させた時の電源側から見たインピーダンス



Figure 11: 1 次負荷を変化させた時の電源側から見たインピーダンス

さらに,同様の条件でのそれぞれの負荷抵抗に供給される電力をオシロスコープにて確認し,オシロスコープ の値より,負荷の変化量に対するその他の負荷にかかる電 力を Figure 13 ~ 15 に示す.変動した負荷抵抗側では負 荷抵抗の変化量に応じて電力が変化したが,それ以外の 一定値の負荷抵抗側では,ほぼ一定の電力を安定して供 給することができていた.これにより,多段化し,それぞ れのサーボモータが独立に動作することで,負荷抵抗が 変動した場合にも安定して電力を供給することができる ことを確認した.



Figure 12: 2 次負荷を変化させた時の電源側から見たインピーダンス



Figure 13: 0 負荷を変化させた時に生じる電力



Figure 14: 1次負荷を変化させた時に生じる電力

# 4 おわりに

アームロボットに対して円板コンデンサを用いた非接触 給電方法が提案されている.それに対して,先端部分への 移行に伴いアームが細くなるタイプのアームロボットに は共振回路の小型化が必要となる.また,提案されていた 回路では多段化する際,共振周波数を一定に保つことが 困難である.これに対して,銅板を多層に重ねることで小 型の複数並列接続されたコンデンサを実現した.また,コ イルはインダクタンスと小型化のトレードオフを考慮し, フェライトコアを用いた.回路を直列共振回路にすること で,多段化の際にも共振周波数を一定に保つ事が容易と なり安定した電力供給を可能とした.今後は,本実験で用 いた材料よりもより優れた結果を出すことを確認したが, 時間の都合上実装し検証することのできなかったレジン基 板,トロイダルコアをそれぞれコンデンサ,コイルとした 共振回路を作製し,現回路との性能比較する必要がある.



Figure 15: 2次負荷を変化させた時に生じる電力

# 参考文献

- [1] 粟井郁雄,川辺健太朗「多関節アーム・ロボット模型 への非接触給電の実験」, RF ワールド, No.38, CQ 出版, pp.105 - 119, (2017).
- [2] 福森康洋,植村渉,粟井郁雄「アームロボットに対 する誘電体多層円板コンデンサを用いた非接触給電 システムの小型化」,IEEE CE ソサイエティ西日本 合同チャプタ主催1月研究会,2018年1月21日.
- [3] 粟井郁雄「とことん基礎から理解する磁界共鳴型ワ イヤレス給電」, 日経エレクトロニクス第2回, No. 1069, pp. 100 - 108, (2011).